

2023年12月吉日

お客様各位

## 『第1回パワーデバイス&モジュール EXPO』出展のご案内

拝啓 御社益々御清栄の事とお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は2024年1月に開催されますネプコンジャパン2024に出展する運びとなりました。  
今回、各用途に合わせたシンターペーストをはじめ、各種はんだ製品を出展いたします。  
皆様方には御来場いただきまして、是非ともニホンハンダの製品をご高覧賜りたくご案内申し上げます。  
※ご来場には事前登録が必要となります。お手数ですが下記URLよりご登録をお願いいたします。

来場登録はコチラ >

<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=0903900866044566-JT3>

### 《展示会概要》

出展展示会：第1回 パワーデバイス&モジュール EXPO

日時：2024年1月24日（水）～26日（金）10:00～17:00

場所：東京ビッグサイト 東4ホール（交通アクセス：<https://www.bigsight.jp/visitor/access/>）

小間番号：E35-38

### 《主な出展製品》

#### ◇パワーデバイス用

- ・無加圧でありながら加圧並みの接合強度を実現した、銅接合可能なシンターペースト。
- ・塗布径130 $\mu$ mが可能な微小塗布対応ソルダペースト。
- ・大面積でもボイド低減・部品ずれ抑制に特化したSAC305合金ソルダペースト。
- ・高信頼性合金を使用した、ボイド低減タイプソルダペースト。

#### ◇SMT用

- ・ぬれ性・ボイド特性に優れ、微小～大面積まで対応可能な汎用型ソルダペースト。
- ・90 $^{\circ}$ Cの低温接合、加熱温度を上げると時間短縮可能なエポキシ系導電性接着剤。

#### ◇開発品、参考出品

- ・フィラー入りソルダペースト
- ・無加圧銅シンターペースト
- ・マイクロLED / RF デバイス向けシンターペースト

社員一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具